

世界をリードする日本の半導体産業を加速させる、新たなサミット

APCS

Advanced Packaging
and Chiplet Summit

2022年12月14日(水)-16日(金) 10:00-17:00

東京ビッグサイト(東展示棟 1・2・3ホール)

入場無料・事前登録制

主催:  SEMI

www.semiconjapan.org/jp/apcs



半導体パッケージング、基板実装分野の トッププレイヤーが集結

半導体の進化を後押しする後工程、パッケージング技術が注目されています。

2.5D・3D、RDL、TSV、チップレット、ボンディング技術などに関する最新技術の紹介、
国内外のトッププレイヤーの講演による最新情報を提供します。



展示

業界をリードする主要企業による
最新技術、サービスの展示



カンファレンス

アドバンスドパッケージング、
チップレットの世界の
トッププレイヤーが多数講演



ネットワーキングイベント

世界のVIP、キーマンが結集
関係作りの強化、
新たなビジネスチャンスの中

SEMICON Japan 同時開催

世界をリードする
日本の半導体産業を加速させる、
新たなサミット

APCS

Advanced Packaging
and Chiplet Summit

世界を代表するマイクロエレクトロニクス製造サプライチェーンの国際展示会

SEMICON® JAPAN

未来を変える。未来が変わる。

2022年12月14日(水)-16日(金) 10:00-17:00

東京ビッグサイト(東展示棟・会議棟)

入場無料・事前登録制

主催:  SEMI

www.semiconjapan.org



貧困、飢餓、医療、教育、

水、エネルギー、気候変動...

地球規模の課題をデジタルの力が解決する時代。

その基盤技術の最先端がSEMICON Japanに集まる。

半導体の技術進歩と産業の強靱化が命運を握る。

限界を打ち破るイノベーションがここから始まる。

半導体の未来を変えることで、私たちの未来が変わる。

最新情報・来場登録

[SEMICON Japan](#)

お問合せ

SEMICON Japan 運営事務局
Tel: 050-5804-1281
受付時間: 平日9:30-17:30 (12:00-13:00を除く)
Email: semicon@sakurain.co.jp

半導体技術・産業の未来を 見いだす3日間

展示

半導体サプライチェーンを
つなぐ国内外の主要企業が
一堂に集結

セミナー

トップエグゼクティブを含めた
100名以上の登壇者による
30を超えるプログラム

ネットワーキング

業界をリードする
トップエグゼクティブと
ここでしかない出会いを

若手応援企画

業界の未来を担う
後進の育成を支援する
プログラムの数々

同時開催

APCS Advanced Packaging
and Chiplet Summit

FLEX
Japan

SEMICON Japan 2022 スポンサー

プラチナスポンサー



ゴールドスポンサー



EXHIBITIONS

展示

半導体製造工程全域にわたる 1,500以上のブース

エレクトロニクスデバイス製造のすべてを余すことなく展示します。
展示会とセミナーが一体化した会場で、新しい人脈作りができます。

注目の市場・技術にスポットを当てる企画展示

APCS Advanced Packaging and Chiplet Summit
後工程、パッケージングに関する材料、装置、開発環境、デバイス、製造の最新技術

FLEX Japan 第6回
軽く・薄く・曲がるフレキシブルエレクトロニクスとリジッドなシリコン半導体のハイブリッド技術と、その応用の展示

IoT H/W BIZ DAY 2022 by ASCII STARTUP

ものづくりとテクノロジーにかかわるスタートアップ企業による、ハードウェアビジネスの最新潮流を捉えた展示

地域パビリオン

- ・ TOHOKUパビリオン
- ・ 九州パビリオン

テクノロジーパビリオン

- ・ 第5回 パワー・化合物半導体パビリオン
- ・ 第1回 航空機サプライヤーパビリオン
- ・ 第4回 スマートマニファクチャリングパビリオン
- ・ 第3回 量子コンピューティングパビリオン

SEMI is MORE Path

スマートモビリティ、スマートデータAI等、様々な分野とのコラボレーションと直接対話の機会を提供

Workforce Development 東1ホール

これからの業界を担うZ世代応援プログラムです。

未来COLLEGE
半導体業界研究イベントとして、対面とオンラインでの説明会をご用意します。

The 高専
高専生の若きアイデアにあふれた技術や研究成果を展示します。

TECH CAMP 東5ホール
若手社員がハッカソンの成果をステージで発表します。

アカデミア
日本全国の大学研究室が成果を展示し、産学連携や共同研究等の機会を提供します。

アカデミアAward (New!)
「アカデミア」出展の研究室が成果を発表します。表彰を行い、未来の研究を後押しします。

Workforce Development スポンサー (アルファベット順)



好評につき今年も開催! SEMICON x YouTuber ものづくり太郎

NETWORKING EVENT

ネットワーキングイベント

リアル展示会でこそご提供できるリアルなコミュニケーション。
参加者のビジネス創出の機会をサポートいたします。

APCS ネットワーキング

12/15(木) 17:00 東2ホール SuperTHEATER
APCS講演者・出展者・委員等の関係者による交流会

FLEX ネットワーキング

12/14(水) 17:00 会議棟8F アルポルト
フレキシブルデバイス分野の関係者による交流会

STS GETOGETHER

12/15(木) 17:00/先端デバイス・プロセスデバイス
12/16(金) 17:00/先端リソグラフィ 会議棟8F アルポルト
STS講演者・聴講者・企画委員や関連出展者との交流会

SEMINAR

セミナー

半導体業界の“未来が見える”講演の数々

SuperTHEATER

東2ホール SuperTHEATER 無料

SEMICONだから実現した世界のトップエグゼクティブ、エキスパートのビジョンとインサイトに満ちた講演をお見逃しなく。

注目のキーノート

オープニングキーノートパネル -グローバルリーダーを目指す産官学戦略-

2020年に甘利明衆議院議員、五神真東京大学教授(当時)、東哲郎東京エレクトロンチェアマン・エメリタス(当時)の鼎談から発信された日本の半導体産業への提言について、ダリオ・ギルIBMリサーチディレクターを交えて改めて議論します。

Bulls & Bears -半導体製造装置市場の減速と成長再開のシナリオ-

社会のデジタル化を背景に急成長する半導体とそのサプライチェーンに、減速懸念が広がっています。半導体製造装置市場の後退の程度と期間、その後の成長再開はどうか、トップ証券アナリストが議論します。

Advanced Packaging and Chiplet Summit 2022 -グローバルリーダーによるパッケージングの未来-

アドバンストパッケージング業界のリーディングベンダが2.5D/3D、チップレットなどを活用した最新情報をもとに今後のビジョンや方向性を語ります。

グランドフィナーレパネル -日本半導体の躍進を支えるサプライチェーン戦略-

日本の半導体産業は、いわゆる「失われた30年」からの成長再開に向けて力強い一歩を踏み出しました。大きく様変わりした市場環境の中で、国内の枠組みから抜け出した国際協力のもと、サプライチェーンや人材などの課題に対して、協調して取り組むべき戦略を議論します。

業界の第一線で活躍するスピーカー陣



自由民主党 衆議院議員
自民党 経済安全保障推進本部 本部長
半導体戦略推進議員連盟 会長
甘利 明



TIA運営最高会議 議長
半導体・デバイス産業戦略検討会議 議長
東 哲郎



日本電信電話
代表取締役会長
澤田 純



Intel
Fellow
Ravi Mahajan



IBM
Senior Vice President and Director of IBM Research
Darío Gil



理化学研究所
理事長
五神 真



ソニーグループ 上席事業役員
ソニーセミコンダクタソリューションズ
代表取締役社長 兼 CEO
清水 照士



Qualcomm
VP - Engineering
Chidi Chidambaram

会議棟イベント

SEMI スタンダード会議 会議棟

エレクトロニクス製造のための業界標準を開発する10を超える標準化会議が会期中に予定されています。
参加にはSEMI スタンダード委員登録が事前に必要です。

SEMIスタンダードフレンドシップパーティー

12/15(木) 17:30 会議棟1F
世界のSEMIスタンダード活動メンバーが集う授賞式とレセプション

STS SEMI TECHNOLOGY SYMPOSIUM
会議棟 6F 有料

- 12/14(水) MEMS/テスト/パッケージング
- 12/15(木) 特別セッション(プロセス/マテリアル/インフォマティクス)/先端材料・分析/先端デバイス・プロセス
- 12/16(金) パワーデバイス/先端リソグラフィ

SEMI MARKET
会議棟 6F 有料

- 12/15(木) SEMIの最新の半導体製造装置・材料市場予測に加え、半導体ファブ投資および生産能力動向データ、さらに業界トップアナリストによるエレクトロニクス市場の展望を提供し、複雑化する市場の行方を読み解きます。

FLEX Japan
会議棟 6F 無料

- 12/14(水) 本格実装と市場拡大期を迎えたFHE(フレキシブルハイブリッドエレクトロニクス)の最新動向

APCS SuperTHEATER および 会議棟 6F 無料 ※一部有料

- 12/14(水) 日本、台湾の次世代コンピューティングデバイス&パッケージング開発動向 STSパッケージングセッション(有料)
- 12/15(木) Advanced Packaging and Chiplet Summit 2022
- 12/16(金) ポスト5G社会実現に向けた先端パッケージング技術最前線

Tech & Biz
会議棟 6F 無料 ※一部有料

- 12/14(水) 量子コンピューティング開発最前線/次世代 Mobilityフォーラム
- 12/15(木) 国際EHS規制適合セミナー(有料)/トレーサビリティ・ブロックチェーン
- 12/16(金) IoT H/W BIZ DAY 2022 by ASCII STARTUP/宇宙と地球と半導体 3.0/フォトマスクセミナー(PMJ協賛)

EXHIBITOR SEMINARS
東4ホール 出展者セミナーラーム 無料

出展者による新製品・技術のプレゼンテーションです。
※ 詳細は11月頃WEBサイトに掲載予定です

新型コロナウイルス感染防止対策

政府・自治体および展示会業界のガイドラインをもとに安全を確保して開催いたします。

来場者サポートツール

会場のフロアマップや出展者の詳細情報は11月に公式WEBサイトで公開予定です。



未来を変える。未来が変わる。

SEMICON JAPAN

※2022年10月5日現在 / 掲載内容は変更になる可能性があります。